

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-038

**广东利扬芯片测试股份有限公司**  
**关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路**  
**核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业**  
**集体业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 会议线上交流时间：2026 年 5 月 8 日(星期五)下午 15:00-17:00
- 会议 召 开 地 点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心  
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 28 日(星期二)至 2026 年 5 月 7 日(星期四)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [ir@leadyo.com](mailto:ir@leadyo.com) 进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露《2025 年年度报告》。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司 2025 年度的经营成果、财务状况等，公司计划于 2026 年 5 月 8 日(星期五)下午 15:00-17:00 参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 参与线上互动交流。

**一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范

围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间：2026年5月8日（星期五）下午 15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

公司董事长：黄江先生

公司董事兼总经理：张亦锋先生

公司董事兼董事会秘书、财务总监：辜诗涛先生

公司独立董事：郭群女士

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 4 月 28 日（星期二）至 2026 年 5 月 7 日（星期四）16:00 期间登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [ir@leadyo.com](mailto:ir@leadyo.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

联系方式：0769-26382738

电子邮箱：[ir@leadyo.com](mailto:ir@leadyo.com)

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年4月27日